

スリット加工

絶縁用途や電子用途などの各種素材を
目的に合わせて高精度にスリット加工します。



【特長】

- ・ 一般環境、クリーン環境（Class1,000）など、目的に合わせて加工が可能
- ・ 素材に合わせてバリやスリット屑の出ない加工方法を選定
- ・ 幅公差 20 μ m以下の高精度のスリットに対応
- ・ イエロールームを備え、感光性材料のスリットが可能
- ・ バックアップフィルムや保護フィルムをラミネートしたあとスリット加工が可能

【主な加工素材】

- ・ プラスチックフィルム
- ・ 金属箔
- ・ CCL
- ・ 感光性フィルム
- ・ 絶縁紙
- ・ 不織布
- ・ 貼り合わせフィルム
など



クリーンスリット加工
(イエロールーム内)



銅箔スリット加工

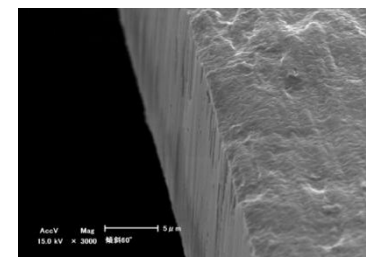


マイクロスリット加工

【代表的な加工条件】

基材厚み μ m	基材幅 mm	巻き径 mm	スリット幅 mm	作業環境
4~1,000	~2,100	~1,000	2~2,000	一般環境 クリーンルーム (Class1,000) CR+イエロールーム

上記以外の基材や加工条件でも対応いたしますので、
詳細はお問い合わせください。



銅箔スリット端面
SEM 観察例

問合せ先 河村産業株式会社 <http://www.kawamura-s.co.jp>
 本社・四日市工場 〒512-8052 三重県四日市市西大鐘町 330 番地 TEL (059) 337-1122
 東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野 1-18-9 黒門平成ビル5階 TEL (03) 5846-8228
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-23-16 セントランドビル4階D室 TEL (06) 6476-7725

初回登録日：2017年7月25日 改訂日：2017年11月17日 Rev.2